

Programme de l'école thématique FIABSÛRF

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
08:00-10:00		CM2.1 : Technologie des assemblages de puissance <i>L. Dupont (SATIE)</i> <i>M-L. Locatelli (LAPLACE)</i>	CM 2.3 : Durée de vie des composants de puissance <i>Z. Khatir (SATIE)</i>	CM2.3 : Composants capacitifs <i>M. Makdessi (YAGEO Group)</i>	CM4.2 : sécurisation des convertisseurs de puissance <i>F. Richardeau (Laplace)</i>
30'		Pause café			
10:30-12:00	Arrivée sur le site Accueil et présentation de l'école	CM3.1: Mécanismes d'endommagement <i>M. Bouarroudj (SATIE)</i>	TD2.3 : Durée de vie des composants de puissance <i>Z. Khatir (SATIE)</i>	CM4.1: Diagnostic orienté fiabilité en EdP <i>P. Venet (Ampère)</i> <i>J. Brandelero (STMicroelectronics)</i>	CM4.3 : Reconfiguration des convertisseurs de puissance <i>A. Gaillard (FEMTO-ST)</i>
12:00-13h30		CM2.1 : Technologie des composants grand gap <i>F. Morancho (LAAS)</i>	Pause déjeuner		
13:30-15:00	CM1.1 : Détermination du MTBF des composants <i>P. Venet (Ampère)</i>	CM3.2: Mécanismes de défaillance <i>D. Trémouilles (LAAS)</i>	CM2.2 : Composants magnétiques <i>M. Makdessi (YAGEO Group)</i>		Bilan et évaluation de l'école
15:00-16:30	TD1.2 : Determination du MTBF des composants <i>L. Théolier (IMS)</i>	CM3.3 : Analyse de défaillance (Méthodes) <i>L. Théolier (IMS)</i>	Atelier: Soutenabilité des convertisseurs de puissance	TR1.1 : Point de vue multidomaines des industriels, aujourd'hui et demain ? <i>M. Piton (ALSTOM)</i> <i>J. Brandelero (STMicroelectronics)</i> <i>S. Azzopardi (Safran)</i>	
30'	Pause café	Pause café	Pause café		Départ
17:00-18:15	Atelier doctorants : Mon poster en 180''	CM3.3 : Analyse de défaillance (Outils) <i>G. Guibaud (Thales)</i>	Activité culturelle		